

TPS650330-Q1 車載用カメラ PMIC

1 特長

- 車載アプリケーション認定済み
- AEC-Q100 グレード 1 認定済み
 - -40°C ~ $+125^{\circ}\text{C}$ の動作時周囲温度範囲
- 3 つの降圧コンバータ:
 - BUCK1 V_{IN} 範囲: 4.0V ~ 18.3V
 - BUCK1 V_{OUT} 範囲: 2.5V ~ 4.0V
 - BUCK1 出力電流: 最大 1500mA
 - BUCK2 および BUCK3 V_{IN} 範囲: 2.5V ~ 5.5V
 - BUCK2 および BUCK3 V_{OUT} 範囲: 0.9V ~ 1.9V
 - BUCK2 および BUCK3 出力電流: 最大 1200mA
 - スペクトラム拡散クロック (SSC) 生成による EMI 低減
 - 2.3MHz の強制固定スイッチング周波数 PWM 動作
- 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータ:
 - V_{IN} 範囲: 2.5V ~ 5.5V
 - V_{OUT} 範囲: 1.8V ~ 3.3V
 - 低いノイズ、高い PSRR
 - $I^2\text{C}$ により出力電圧を調整可能
 - 最大 300mA の出力電流
- ウェットプル・フランク付きの $4.0\text{mm} \times 4.0\text{mm}$ 、24 ピン VQFN

2 アプリケーション

- 車載用カメラ・モジュール
 - サラウンド・ビュー・カメラ・モジュール
 - リア・ビュー・カメラ・モジュール
 - ドライバー・モニター・カメラ・モジュール
 - POC (Power Over Coax) カメラ・モジュール
 - E ミラー・カメラ・モジュール
 - フロント・ビュー・カメラ・モジュール

3 概要

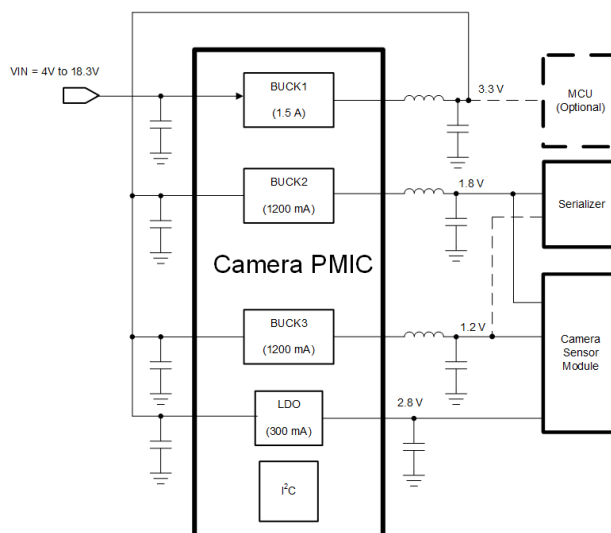
TPS650330-Q1 デバイスは、高度に統合された車載用カメラ・モジュール向け電源管理 IC です。このデバイスは、3 つの降圧コンバータと 1 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータを組み合わせたものです。BUCK1 降圧コンバータは最大 18.3V の入力電圧に対応し、PoC (Power Over Coax) と接続できます。すべてのコンバータは、強制固定周波数 PWM モードで動作します。LDO は 300mA を供給でき、 2.5V ~ 5.5V の入力電圧で動作します。降圧コンバータと LDO の電圧入力は独立しているため、設計とシーケンシングを最大限に柔軟に行えます。

TPS650330-Q1 は、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます ($4.00\text{mm} \times 4.00\text{mm}$)。

デバイス情報

部品番号 (1)	パッケージ	本体サイズ (公称)
TPS650330-Q1	VQFN (24)	$4.00\text{mm} \times 4.00\text{mm}$

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。



TPS650330-Q1 アプリケーション回路



Table of Contents

1 特長	1	5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法	3
2 アプリケーション	1	5.3 サポート・リソース	3
3 概要	1	5.4 Trademarks	3
4 Revision History	2	5.5 静電気放電に関する注意事項	3
5 Device and Documentation Support	3	5.6 用語集	3
5.1 Device Support.....	3		

4 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision A (December 2021) to Revision B (February 2023)	Page
• デバイスのステータスを「事前情報」から「量産データ」に変更.....	1

Changes from Revision * (April 2019) to Revision A (December 2021)	Page
• 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1

5 Device and Documentation Support

5.1 Device Support

5.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項

サード・パーティ製品またはサービスに関するテキサス・インスツルメンツの出版物は、単独またはテキサス・インスツルメンツの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、サード・パーティ製品またはサービスの適合性に関する是認、サード・パーティ製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。

5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.3 サポート・リソース

[TI E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

5.4 Trademarks

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TPS65033000RGERQ1	ACTIVE	VQFN	RGE	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS6503 3000-Q1	Samples
TPS65033007RGERQ1	ACTIVE	VQFN	RGE	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS6503 3007-Q1	Samples
TPS6503300DRGERQ1	ACTIVE	VQFN	RGE	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS6503 300D-Q1	Samples
TPS6503300ERGERQ1	ACTIVE	VQFN	RGE	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS6503 300E-Q1	Samples
TPS6503300IQRGERQ1	ACTIVE	VQFN	RGE	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS6503 300I-Q1	Samples
TPS6503300JRGERQ1	ACTIVE	VQFN	RGE	24	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-3-260C-168 HR	-40 to 125	TPS6503 300J-Q1	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSELETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

⁽⁶⁾ Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

RGE 24

GENERIC PACKAGE VIEW

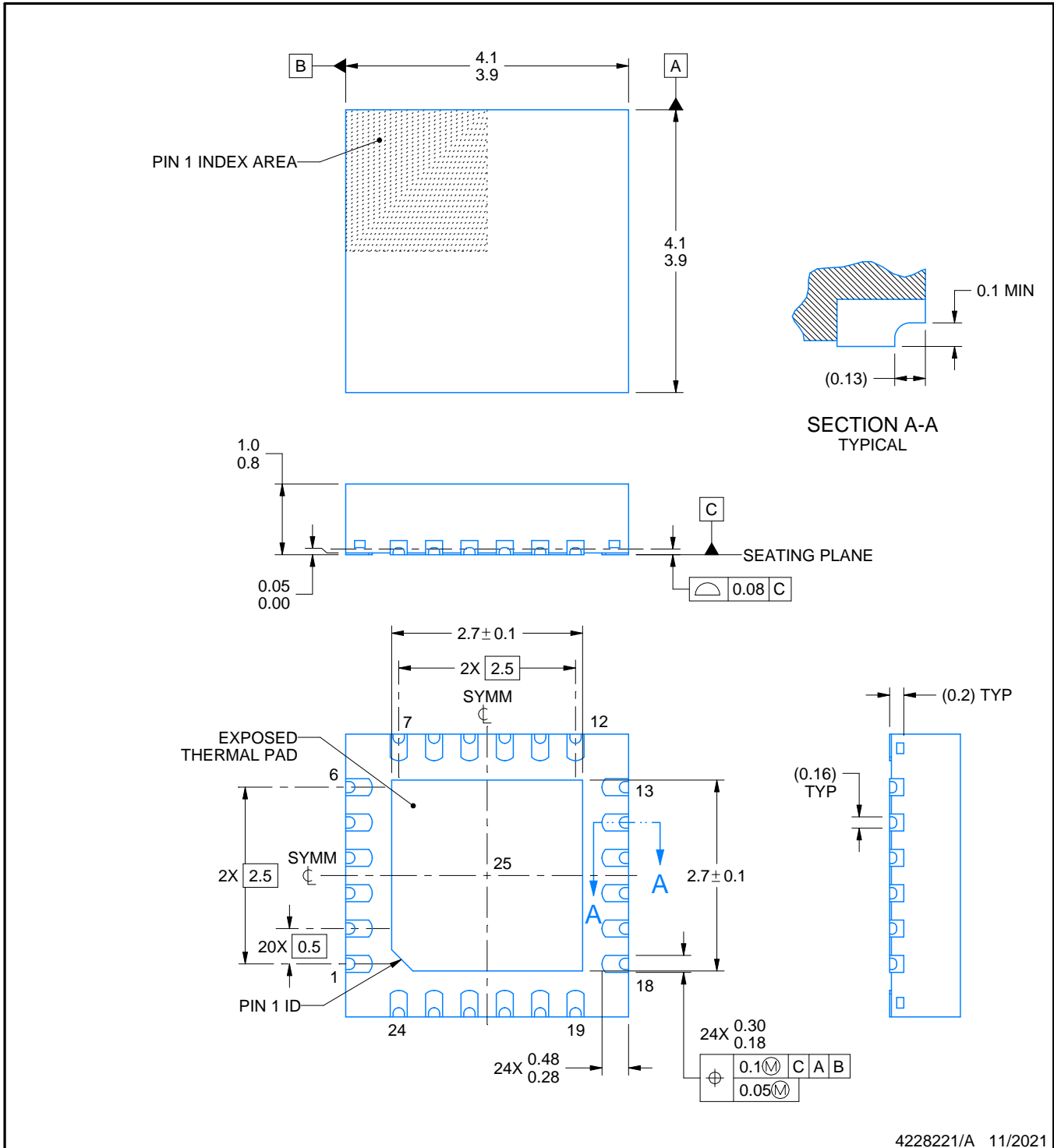
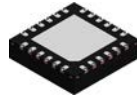
VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4204104/H



4228221/A 11/2021

NOTES:

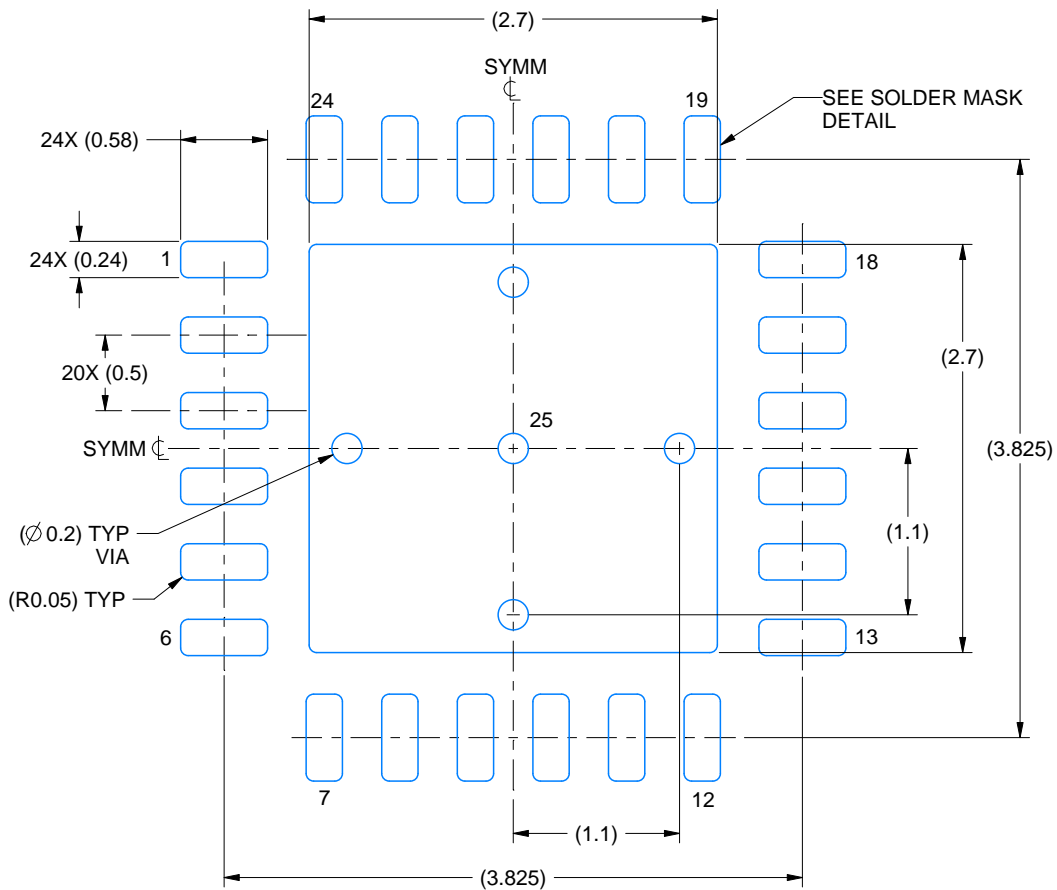
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

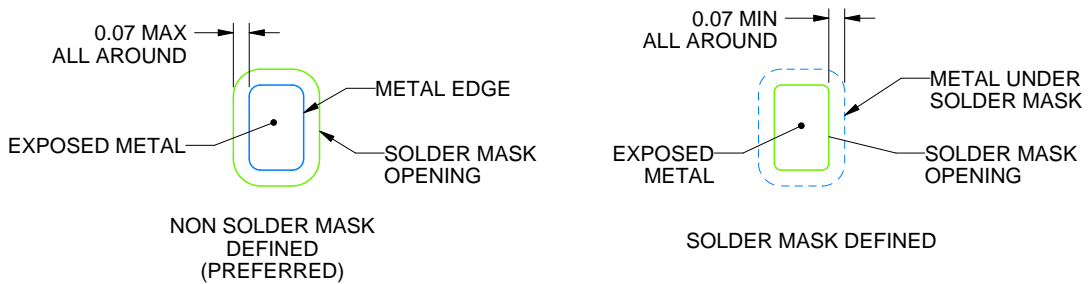
RGE0024U

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



SOLDER MASK DETAILS

4228221/A 11/2021

NOTES: (continued)

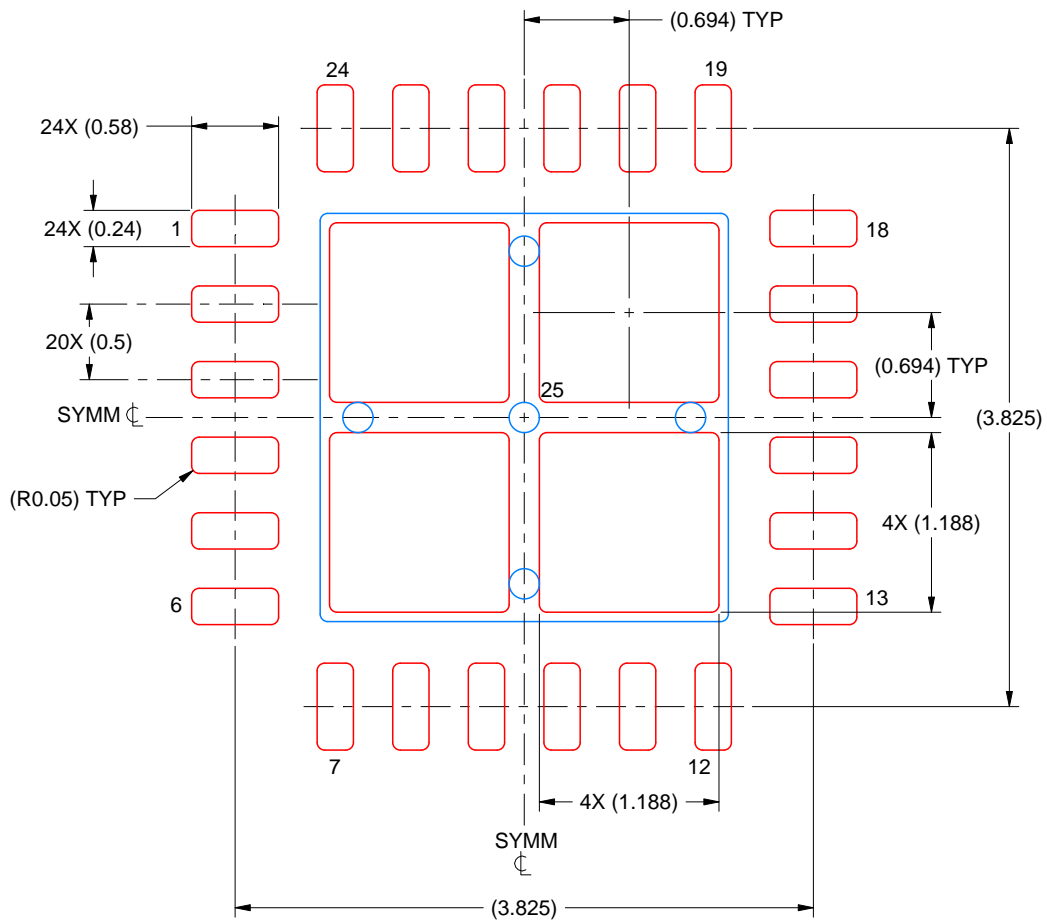
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RGE0024U

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



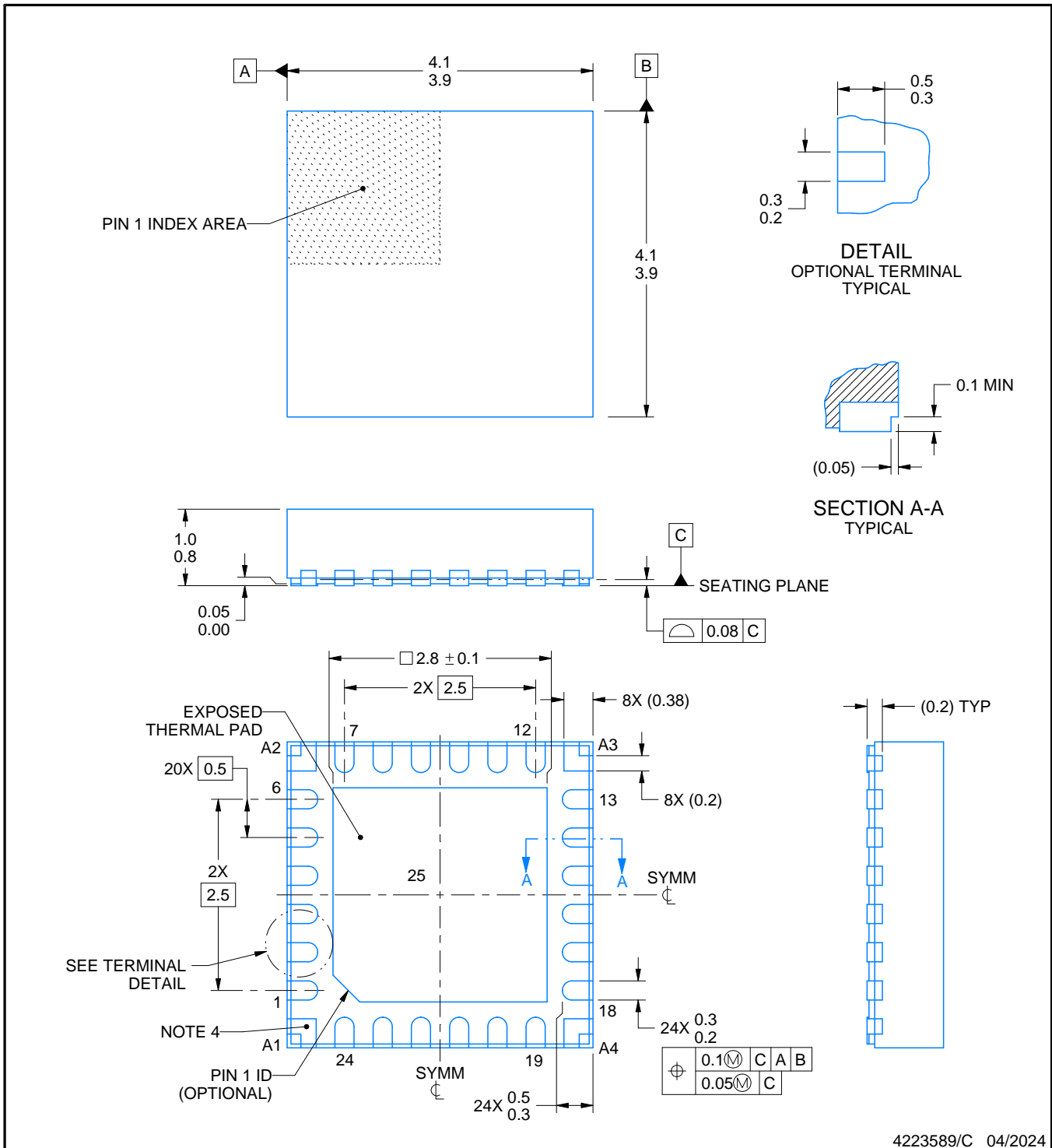
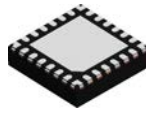
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 20X

EXPOSED PAD 25
77% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4228221/A 11/2021

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.



4223589/C 04/2024

NOTES:

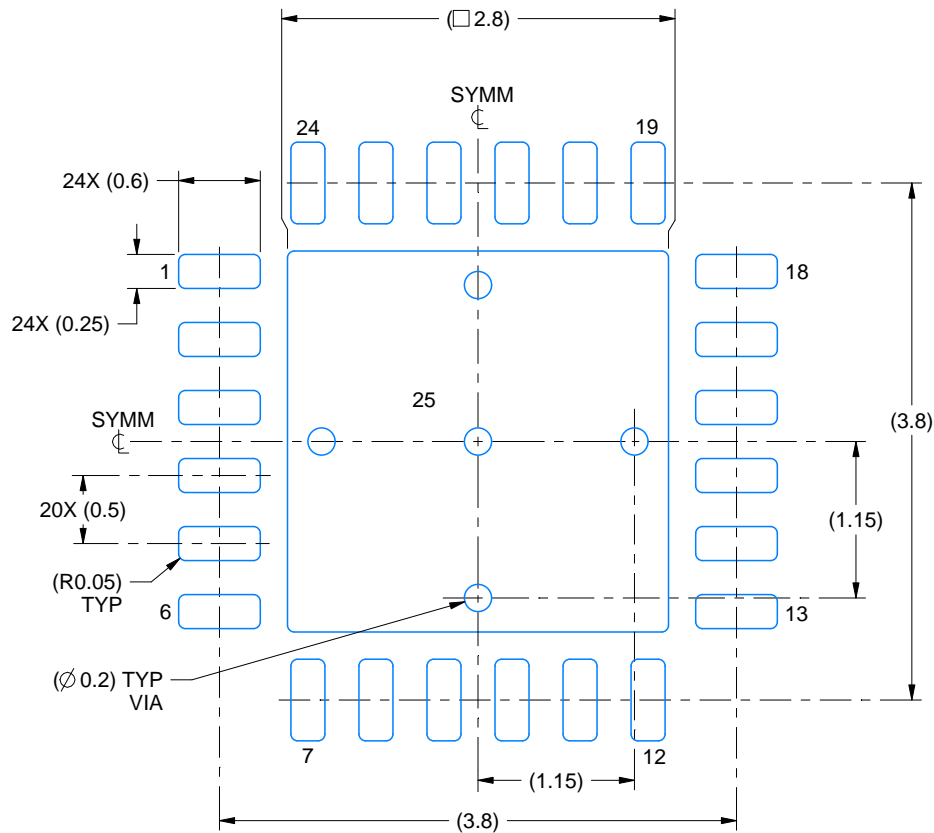
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.
4. Corner pins A1-A4 are physically connected to exposed thermal pad internally. Soldering these is optional, but would require customer to supply land design and stencil.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

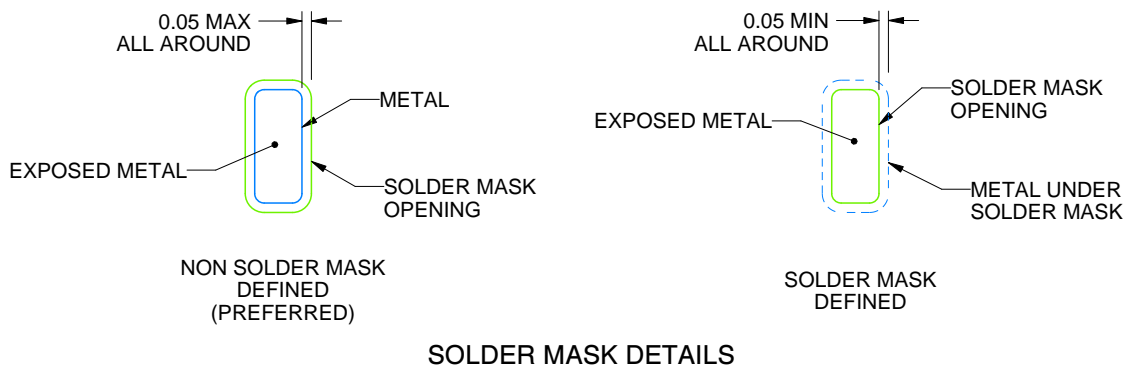
RGE0024K

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X



4223589/C 04/2024

NOTES: (continued)

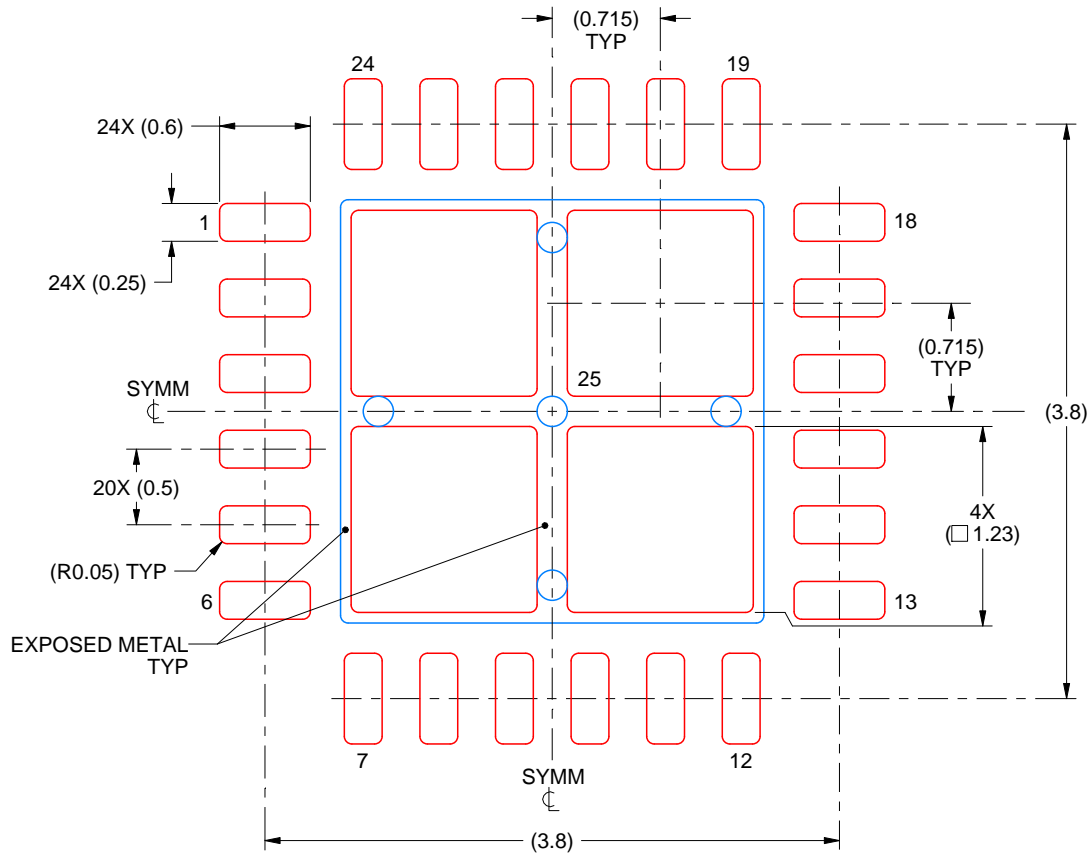
- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RGE0024K

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.1 mm THICK STENCIL

THERMAL PAD 25:
77% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:20X

4223589/C 04/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated